



牛人已开启手机号隐私保护

您可使用BOSS直聘APP扫描二维码联系Ta

5bac8415768be1be1HJy0t-6GFpXy4-2Wf2eW0OannfXMR1e

余青



女 | 26岁 2759247263@qq.com

5年工作经验 | 硬件工程师 | 期望薪资：24-30K | 期望城市：深圳

个人优势

熟练使用 ORCAD,PADS, CAD 软件, 有RK (RK3288,RK3568芯片) 和全志 (vs851) 及国产算能(sg2002&CV184)等芯片的相关设计经验。

工作经历

北京竞业达数码有限责任公司 硬件工程师 2025.07-至今

- 1, 负责项目的硬件开发工作, 原理图和 PCB layout, 协助测试, 分析不良工作等,
 - 2, 编写硬件相关文档
 - 3, 硬件功能调试
 - 4, 熟悉常用高速电路及外设接口
 - 5, 熟练使用烙铁, 热风枪工具, 可焊接 BGA, QFN 等封装芯片和常用元器件
 - 6, 熟练使用pads, orcad, 嘉立创eda设计软件
- 在该司使用的是算能sg2002和cv184芯片, 主要做的产品是人工智能通识实验课的硬件产品

海创半导体科技（深圳）有限公司 硬件 2024.05-2025.05

- 1, 智能门锁项目: 根据客户需求完成器件选型, 原理图和 PCB layout
- 语音项目: 审核客户原理图和pcb, 处理不良
- 2, 编写硬件相关文档
 - 3, 负责语音模组及智能门锁的硬件开发
 - 4, 硬件功能调试
 - 5, 熟悉常用高速电路及外设接口
 - 6, 熟练使用烙铁, 热风枪工具, 可焊接 BGA, QFN 等封装芯片和常用元器件
- 该司使用的是全志v851芯片

深圳晶凌达科技有限公司 硬件工程师 2023.02-2024.04

- 1, 根据客户需求完成器件选型, 原理图和 PCB layout (6层)
- 2, 编写硬件相关文档
- 3, 熟悉瑞芯微 RK 平台, 具有多个量产项目 (广告机, 会议一体机, 自动贩卖机, 高性能多功能等智慧显示类主板)
- 4, 硬件功能调试
- 5, 熟悉 emmc,lvs,edp,pcie,hdmi,mipi,usb 等高速电路及常用外设接口
- 6.熟练使用烙铁, 热风枪工具, 可焊接 BGA, QFN 等封装芯片和常用元器件

江西联益光学有限公司 电子工程师助理 2021.06-2023.01

- 1.熟练使用 PADS 工具;
- 2.熟悉 PCB 的设计 (封装, 布线)、了解加工、SMT 流程, 并能协助生产, 品质分析问题和措施;

- 3.熟悉电路板设计,具有2层&4层板的 Layout 经验; 熟悉 PCB 布线的规则;
- 4.协助电子电路的调试和相关文档编写;

教育经历

洛阳理工学院 本科 机械电子工程 2017-2021

资格证书

计算机二级 大学英语四级